

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

## 金名信息技术股份有限公司 关于拟向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、贷款基本情况

根据经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司包头分行申请流动资金贷款人民币壹佰肆拾柒万元（¥1,470,000.00元），期限12个月，授信用途为补充公司流动资金；董事班晓峰及其配偶为此笔贷款提供连带信用担保责任。

具体内容以公司实际签署贷款合同为准。

### 二、审议和表决情况

公司于2023年8月3日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司包头分行借款不超过人民币147.00万元的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本项议案表决结果如下：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、贷款的必要性及对公司的影响

上述银行贷款是为补充公司流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续经营，对公司生产经营将产生积极影响，符合公司及全体股

东利益。因此上述贷款是合理和必要的。

#### 四、备查文件

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月03日